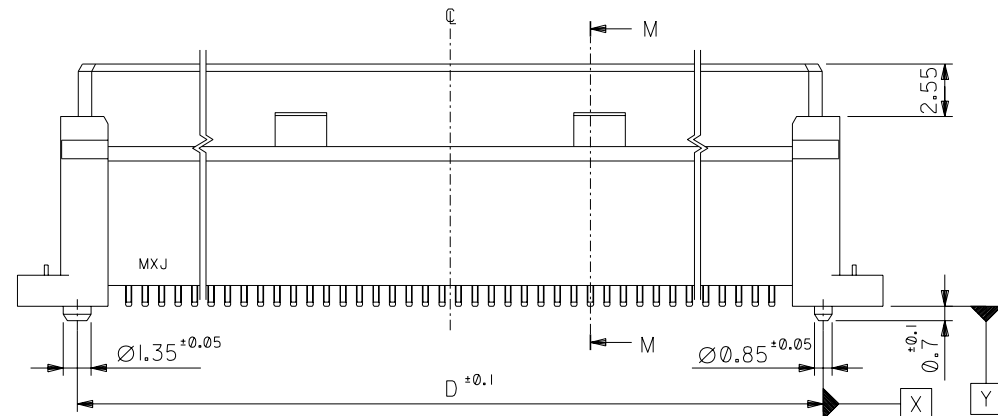
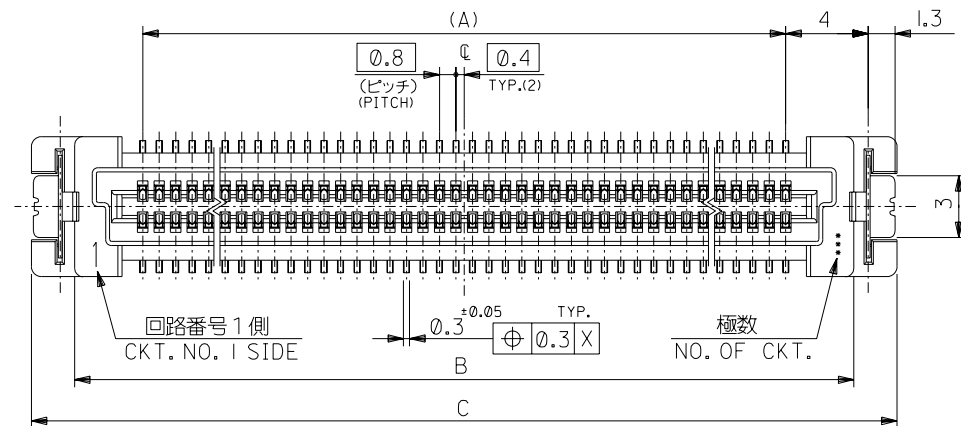
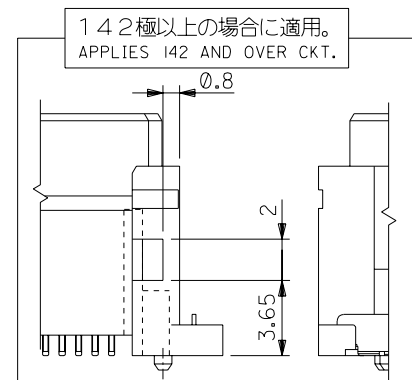


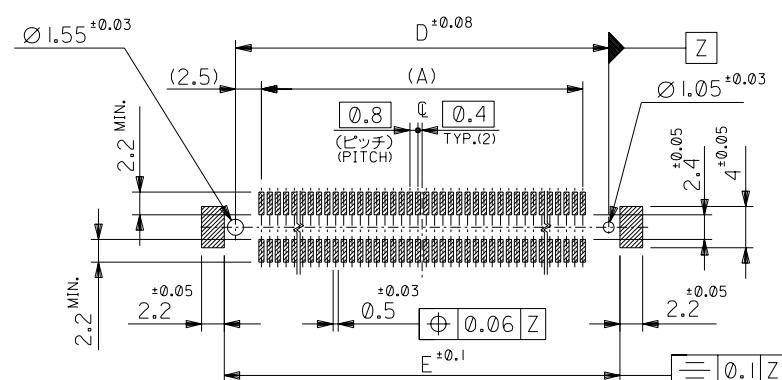


注記
NOTES

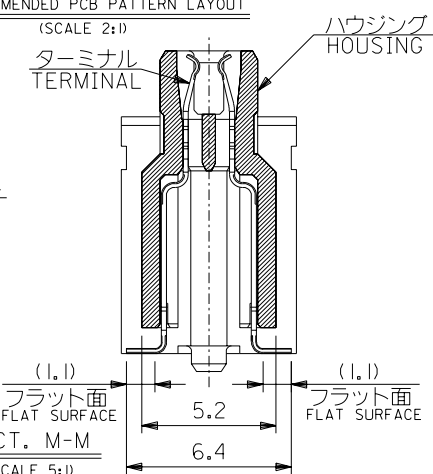
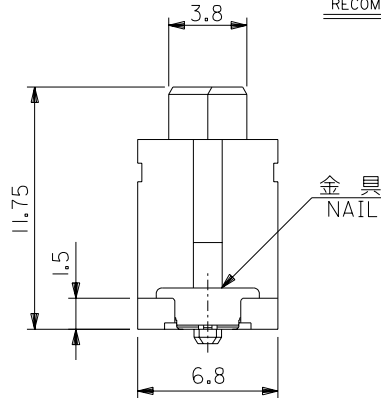
- 材質
MATERIAL
ハウジング : ガラス入り LCP、白色、UL94V-0
HOUSING : G.F.LCP, WHITE, UL94V-0
ターミナル : ベリリウム銅 (t=0.2)
TERMINAL : BERYLLIUM COPPER
金 具 : 燐青銅 (t=0.2)
NAIL : PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様
PLATING
ターミナル : 接点部 : 金メッキ 0.2μmMIN.
TERMINAL : CONTACT AREA : GOLD 0.2μmMIN.
半田付け部 : 錫メッキ 1.0μmMIN.
SOLDER TAIL AREA : TIN 1.0μmMIN.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.3μmMIN.
UNDER-PLATING : NICKEL 1.3μmMIN.
金 具 : 錫メッキ 1.0μmMIN.
NAIL : TIN 1.0μmMIN.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.0μmMIN.
UNDER-PLATING : NICKEL 1.0μmMIN.
- ターミナル及び金具の半田付け面のバラツキ寸法
TERMINAL AND NAIL COPLANARITY
Y面を基準とし、上へ0.05下へ0.1の範囲にあり、
且つテール平坦度は、0.1 MAX. とする。
TAILS TO BE WITHIN 0.05 UPWARD AND 0.1 DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE.
AND TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.
- 同一基板内に複数個 (2ヶ以上) の使用は避けてください。
MXJ DOES NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS
BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.BOARD.
- 本製品は 52777-***0 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52777-***0.



52777-***70	MODEL NO.
一般公差 GENERAL TOLERANCES	



推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE 2:1)



78.4	76.2	82	77.8	71.2	52777-1870	180
62.4	60.2	66	61.8	55.2	52777-1470	140
46.4	44.2	50	45.8	39.2	52777-1070	100
38.4	36.2	42	37.8	31.2	52777-0870	80
30.4	28.2	34	29.8	23.2	52777-0670	60
22.4	20.2	26	21.8	15.2	52777-0470	40
E	D	C	B	A	MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKTS.

材料
MATERIAL
注記参照
SEE NOTES

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

仕上げ
FINISH
注記参照
SEE NOTES

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称

適用電線範囲
WIRE RANGE
被覆外径
INS. RANGE

0.8 BOARD TO BOARD CONN.
REC. HOUSING ASS'Y (H=11.75)
-LEAD FREE-

DRAWN BY '04/03/12 CHK'D BY '04/03/12
M.NABEI K.TOJO
APP'D BY '04/03/12 尺 度
M.SASAO SCALE

DWG. NO. SD-52777-005 REV 0

